

2017年5月12日

マルチプロセス対応パッケージボンダ FPB-1ws NeoForce 受注開始

株式会社新川（社長：長野高志、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、マルチプロセス対応パッケージボンダ FPB シリーズの第二弾として、ウェーハ・基板対応機種である「FPB-1ws NeoForce」を開発し、受注を開始します。

FPB シリーズは、ハイエンドデバイス向け Thermal compression bonding 工法の課題であった生産性を大幅（2.4 倍/装置：当社比）に向上させるとともに、C2、C4、FO-WLP 等の各種工法に対応したボンダです。昨年、シリーズの第一弾として、基板へのチップ搭載プロセス（Chip to Substrate：C2S）に特化した FPB-1s NeoForce を市場投入しました。

近年、最先端メモリ・ロジック生産において、ウェーハにチップを搭載するプロセス（Chip to Wafer：C2W）による 3 次元/2.5 次元実装が開始されており、先端実装装置に対するウェーハ対応への要求が急速に高まっています。FPB-1ws NeoForce は、高生産性を維持しながら、市場の変化に合わせて C2W・C2S の選択を可能とし、お客様のビジネス拡大に貢献します。

なお、同時に C2W に特化した「FPB-1w NeoForce」を FPB シリーズのラインナップに加え、IoT (Internet of Things) 時代の到来によるプロセスの多様化にフレキシブルに対応していきます。



【FPB-1ws NeoForce の特長】

- Chip to Wafer / Substrate 対応マルチプロセス工法パッケージボンダ
- 独自の NVS[Non Vibration System]、FFG[Force Free Gantry]により、高荷重高精度実装を実現
- マルチヘッド化により、高生産性/省スペース化を実現
- マルチダイハンドリング対応 品種自動切り替え機能で 4 品種までの異種チップ実装対応
- 生産性/フットプリント 約 3 倍向上(当社比)

- その他当社取扱製品
ワイヤボンダ、ダイボンダ、フリップチップボンダ

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：グローバル営業統括部 志村 達也（TEL：042-560-1225）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上